

射频前端封装 苏州捷研芯有限公司 浙江封装

产品名称	射频前端封装 苏州捷研芯有限公司 浙江封装
公司名称	苏州捷研芯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路2号东景工业坊56幢
联系电话	13915543356

产品详情

压力传感器被广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。力学传感器的种类繁多，如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器，它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性，下面我们主要介绍这类传感器。

MEMS封装的特殊性大大增加了MEMS封装的难度和成本，射频前端封装，据估计，MEMS器件的封装成本占整个MEMS成本的50%~90%，成为MEMS进一步发展的瓶颈。目前，国内MEMS封装技术比较落后，必须予以重视，并积极发展MEMS封装技术。

封装材料

一般来说，MEMS器件对封装材料有如下要求:封装材料的电导性要低，倒装封装技术，以降低电信号传送的干扰;传热性要好，浙江封装，对某些应用是需要散热，而另一些应用，诸如热传感器，则要求其与外界的温度保持一致;密封性能要好，对一些微机械结构而言，空气中的某些气体成分对其有腐蚀作用，而且杂质也会影响微机械系统的正常工作，因此要求封装材料具有良好的密封性能，才能保证器件的高可靠性。目前，用于MEMS封装的材料主要有陶瓷、金属和塑料等几种网。

在过去10年里，微机电系统(MEMS)大量地“借用”那些起初是为军方高可靠性应用而开发的封装

技术。虽然这类封装在MEMS中的表现良好，但与之相关的成本却高达单个MEMS器件价格;70%。现在，随着晶圆级封装(WLP)和微流体技术的进步，MEMS封装技术也在不断演化发展。

在MEMS生产制造过程中，晶圆制造占成本比例低，反倒是封测成本高，约占50%，主要在晶圆端MEMS只需采用0.35~0.5 μm 等成熟制程，不需进入更高阶制程，Fbar封装，不过封装端的精密度却远高于半导体封装，测试时间也较长，因此成本较高。

射频前端封装-苏州捷研芯有限公司-浙江封装由苏州捷研芯纳米科技有限公司提供。苏州捷研芯纳米科技有限公司(www.jyxsolution.com) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的传感器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领苏州捷研芯和您携手步入辉煌，共创美好未来！